当前高端 MLCC 结构性紧缺格局持续确认，三星电机订单交付周期已拉长至 52 周，年内累计相关订单额约 2.4 万亿韩元，全球客户争相锁定 2027 年产能，村田、太阳诱电、三星电机三大海外龙头相继上调 AI 服务器高容高压、车规级产品价格，涨幅普遍达 10%-25%，行业呈现高端量价齐升、低端消费级疲软的分化态势。需求端由 AI 服务器与新能源车双轮驱动，高端 AI 服务器单机 MLCC 用量可达 2.8 万颗以上，是传统服务器的 8-10 倍，新能源车单车用量也达燃油车的 3-4 倍，叠加 800V 高压平台与智能驾驶渗透，共同推动高端需求快速扩容；供给端海外龙头主动缩减中低端料号，将产能向高端赛道集中，而高端产能扩产周期长达 2 年以上，短期紧缺难以缓解，叠加国产替代加速，国内头部企业迎来份额提升与产品结构升级的双重机遇，投资可沿具备高端突破能力的国内 MLCC 龙头以及上游陶瓷粉体核心材料等主线布局。

MLCC 交付周期拉长，AI+车规驱动结构性景气与国产替代机遇

据韩媒《先驱经济》报道，受 AI 算力需求急剧增长拉动，三星电机 MLCC 产品交付周期于 10 月进一步延长至 52 周，覆盖低容量、高容量及车载全品类，供应紧张程度持续升级。订单端全球大型客户正加速签订年度供货合同、提前锁定 2027 年全年产能，今年以来三星电机已披露的 MLCC 相关订单累计约 2.4 万亿韩元，其中 9 月签下 2850 亿韩元全年供货合同，8 月更是创下单笔 7.8 亿美元的史上最大 MLCC 订单纪录。产能端其组件事业部上半年产能利用率已达 91%，接近满负荷运转，而菲律宾扩产项目预计 2027 年后才能量产，短期内高端供给瓶颈难以有效缓解。

供需失衡之下，全球 MLCC 龙头集体开启涨价周期，日本村田、太阳诱电与韩国三星电机相继发布涨价函，AI 服务器高容高压、车规级高端产品原厂涨幅普遍达 15%-35%，部分紧缺规格现货涨幅更为显著。其中村田 4 月率先对高端产品线提价并停产部分消费级常规料号，将产能向高端倾斜；太阳诱电 7 月跟进调价、9 月正式落地新价格体系；三星电机 8 月宣布全线 MLCC 上调 30%，通过价格手段抑制中低端需求、优先保障高端客户交付，行业整体呈现高端产品量价齐升、消费电子中低端需求疲软的结构性分化格局，并非全行业普涨行情。

图一：MLCC 产业链涨价情况

厂商	涨价时间	涨幅	产品	原因
国巨	2026 年 7 月 1 日	50%	MLCC 电容产品	跟随涨价
华新科	2026 年 6 月 1 日	5%-10%	电阻及部分电容	多项成本上涨以及需求提升
村田	2026 年 4 月 1 日	15%-35%	AI 服务器高容 MLCC、高端车规级 MLCC	AI 服务器需求井喷，产能利用率上升
太阳诱电	2026 年 5 月 1 日	5%-10%	MLCC、电感器、射频器和铝电解电容器	需求旺盛，原材料价格上涨
三星电机	2026 年 8 月 1 日	30%	全系 MLCC	产能利用率上升以及需求提升
三环集团	2026 年 9 月 1 日	30%	高端 MLCC	跟随涨价
风华高科	2025 年 11 月	10%-20%	瓷介电容类产品	行业供给紧缺，需求提升较多

资料来源：各公司公告

➢ 核心驱动：AI+车规双轮共振，结构性紧缺而非全面普涨

本轮 MLCC 景气的核心逻辑是需求结构性爆发与供给结构性错配，而非行业全面复苏。增量需求高度集中于 AI 服务器与新能源车两大高景气赛道，传统消费电子需求仍处低位。

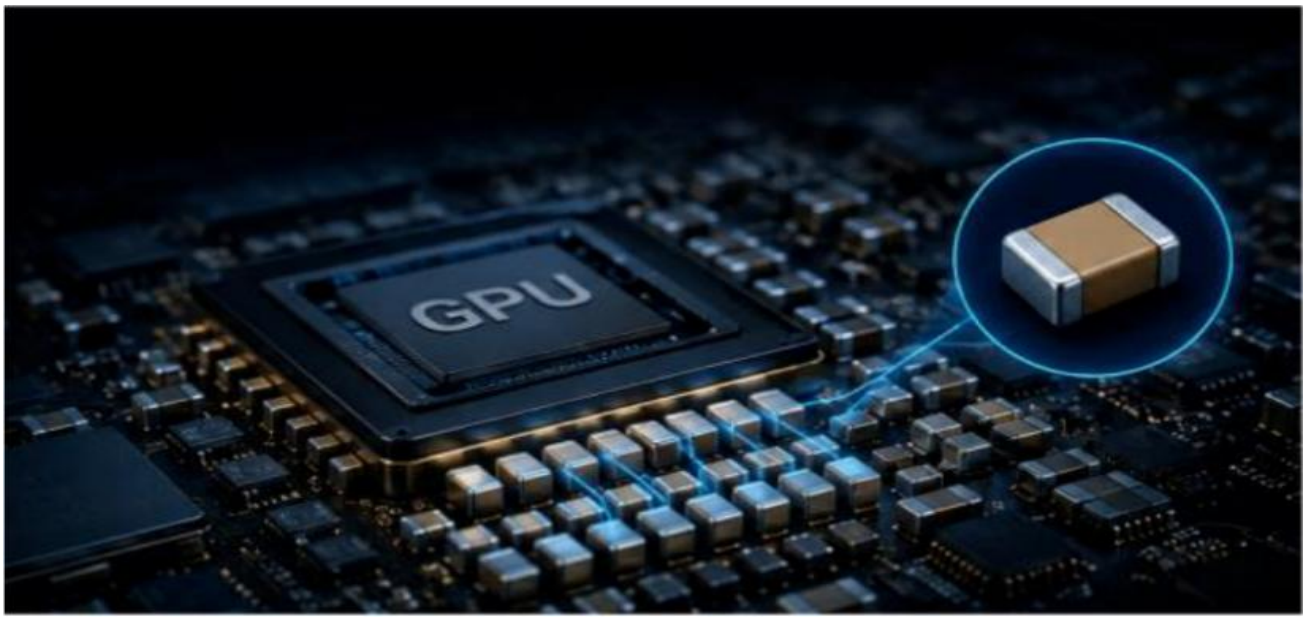
*需求端：两大高端赛道驱动用量指数级增长

AI 服务器：单机用量 8-10 倍扩容，高容高压成刚需

MLCC 被誉为“电子工业大米”，承担储能、滤波、稳压等核心功能。传统通用服务器单机 MLCC 用量约 2200-3000 颗，而 AI 服务器单机用量大幅攀升至 2.2 万- 2.8 万颗，达到传统服务器的 8-10 倍；英伟达高端 AI 整柜机型用量更高达数十万颗，下一代平台用量预计再增 30%以上。除了数量激增，规格要求也同步升级：AI 服务器 GP 供电已升级至 48-54V，高容值 MLCC（1μF 以上）用量占比从传统服务器的不足 40%提升至 60%以上，小尺寸、高耐压、耐高温规格成为标配。高容 MLCC 对产能的消耗约为普通产品的 7 倍，且成品率更低，进一步加剧了高端产能的紧张程度。

財富管理 | 資產管理 | 經紀業務 | 資本市場
VICTORY SECURITIES
TRANSFORMING YOUR GOALS INTO REALITY 成就您想未來

图二：AI 服务器里面的 MLCC



资料来源：AI 芯天下公众号

新能源车：单车用量 3-6 倍提升，车规壁垒强化稀缺性

汽车电子是另一核心增长极。传统燃油车单车 MLCC 用量约 3000 颗，混动车型约 1.2 颗，纯电车型可达 1.8 万颗，是燃油车的 3-6 倍；高端智能电动车叠加 800V 高压平台、L2 +以上智驾系统，单车用量可突破 2 万颗。车规级 MLCC 对可靠性、温度范围、抗振动能力要求远高于消费级，认证周期长达 2-3 年，供给壁垒更高。当前全球车规 MLCC 产能同样高度集中于村田、三星电机、太阳诱电三家，海外龙头产能优先保障 AI 赛道，车规供给同步偏紧。

***供给端：海外产能倾斜高端，扩产周期长难解近渴**

海外龙头正主动进行产能结构腾挪，村田、三星电机等头部厂商相继缩减消费级中低端料号的产能投放，逐步将原有产线改造升级为适配高容高压、车规级的高端产线。在 AI 与车规赛道需求确定性强、产品利润率显著高于消费级的背景下，头部企业主动收缩中低端供给、集中资源保障高价值订单交付，也使得大量中低端常规订单自然向国内 MLCC 厂商溢出，为国内企业带来份额提升与客户导入的窗口期。

高端 MLCC 的产能扩张存在极强的时间与技术壁垒，一条高端产线从厂房建设、设备引进调试，到完成工艺磨合、良率爬坡，再到通过下游车规级 AEC-Q200 认证与头部客户的严苛导入验证，整体周期长达 2 年以上。同时高容高压产品要求陶瓷介质层薄至亚微米级别，对材料配比、叠层精度、烧结控制、批次一致性要求极高，新进入者难以在短时间内突破工艺与良率瓶颈，这也意味着当前的高端产能紧缺格局难以在短期内得到有效缓解。

上游核心原材料的供给约束同样制约着行业产能扩张节奏，高端 MLCC 所需的纳米级钛酸钡陶瓷粉体、超细镍电极浆料等核心材料，长期被日本堺化学、昭和电工等企业主导技术与供给，具备极高的技术壁垒，整体供给弹性十分有限。即便下游需求持续高涨，材料端的产能释放速度也难以快速匹配，国内厂商虽在中高端粉体领域已实现突破，但 AI 服务器用超高容规格的超细粉体仍与海外龙头存在差距，成为限制高端 MLCC 整体产能扩张的另一重关键因素。

➢ 产业趋势：高端量价持续上行，国产替代迎来黄金窗口

*高端赛道：长单锁定+ASP 上行，盈利持续性增强

与过往消费电子驱动的短周期涨价不同，本轮 AI 与车规需求具备长周期、高确定性特征。海外龙头普遍与客户签订 1-3 年长期供货协议（LTA），订单能见度显著提升；同时产品 ASP 持续上涨，量价齐升之下盈利质量大幅改善。目前 MLCC 正从周期性“电子大宗商品”向 AI 时代的“战略供应链资源”转变，高端供需错配格局预计将延续至 2028 年，行业景气周期长度远超历史水平。另外，MLCC 上游核心原材料陶瓷粉体（钛酸钡、氧化锆等）直接决定产品性能，此前高端瓷粉高度依赖日本企业。随着国内 MLCC 厂商产能扩张与产品升级，上游国产粉体材料迎来验证与导入机遇，具备技术壁垒的上游材料企业同样受益于行业景气与国产替代双重逻辑。

*中低端赛道：海外订单溢出，国产厂商加速份额提升

海外龙头聚焦高端市场后，中低端通用型 MLCC 订单持续向中国大陆、中国台湾厂商转移。国内头部企业凭借成本优势、稳定交付能力，快速承接溢出订单，同时逐步向中高端产品升级，实现“量增+价稳+结构优化”的三重利好。长期来看，国内厂商从消费级中低端切入，逐步向车规、工业级突破，国产替代空间广阔。当前全球前五大厂商占据近八成市场份额，国内龙头市占率仍处个位数，提升潜力巨大。

➢ 产业链核心股票有哪些？

国内 MLCC 中游制造环节核心标的以风华高科（000636.SZ）、三环集团（6951.HK）为双龙头，二者是国内产能规模最大、技术布局最全面的厂商。风华高科（000636.SZ）是国内 MLCC 产能规模第一的企业，实现全尺寸全品类覆盖，多款车规产品已通过 AEC-Q200 认证并进入头部车企供应链，2026 年上半年汽车电子、工控业务分别实现 30%、54%的高速增长，高容新品研发持续推进；三环集团（6951.HK）则是电子陶瓷全产业链龙头，依托高端陶瓷粉体 100%自给的成本优势，MLCC 业务量价齐升，2026 年上半年营收与净利润均实现 50%以上增长，是行业内盈利能力最强的头部厂商。上游材料与特种 MLCC 赛道同样有核心标的，是产业链中确定性较强的环节。上游材料端，国瓷材料（300285.SZ）是国内介质粉体绝对龙头，国内市占率约 80%、位居全球第二，产品批量供货村田、三星电机等海内外头部厂商，同时持续开发高容、车规专用电子浆料，直接受益于高端 MLCC 需求扩

容；特种 MLCC 领域，火炬电子(603678.SH)聚焦军工级高可靠 MLCC 产品，具备极高的资质壁垒与客户粘性，在军工电子信息化加速的背景下需求稳健增长，盈利稳定性显著优于通用型产品厂商。

风险提示方面，·MLCC 行业面临多重不确定性：若 AI 资本开支放缓或新能源车销量下滑，高端 MLCC 需求增速将受直接影响，当前供需紧张格局或随之缓解；若海外龙头扩产进度快于预期，或新进入者突破技术壁垒，本轮产品价格上涨的幅度与持续时长可能低于预期；国内厂商高端产品的技术突破、客户认证进度若不及预期，将制约其市场份额提升节奏与盈利改善幅度；中低端消费级 MLCC 需求仍处低位，若消费电子复苏乏力将拖累相关厂商整体业绩；同时陶瓷粉体、金属电极等原材料价格大幅波动可能扰动企业盈利水平，而国内厂商若集中扩产中低端产能，还可能引发价格竞争、压缩行业利润空间。

免責聲明：本報內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本報內容僅供參考，不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券與虛擬資產價格可升可跌，尤其虛擬資產的風險極高，投資者應對有關產品保持審慎及自行承擔投資風險。